

创新功能材料领军企业

## H200-LD 专用系列

## 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

## 应用特点:

- 高导热
- 低密度
- 高绝缘
- 防火性能高

## 应用领域推荐:

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

**储存条件**:阴暗处储存 储存温度:≤30℃ 储存湿度:≤70%

堆放高度不超过7层,而且总高度不超过1M

保质期:

在储存条件下:二年 不符合储存条件下:六个月

鸿富城 H200-LD 系列导热硅胶垫片,是一款局导热低密度热界面材料。产
品具有优异的电气绝缘特性,自然粘性和防火性能,并且有较好的回弹性及撕裂
强度。能够很好地填充间隙,实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具
工艺性和使用性,是一种极佳的导热填充材料,被广泛应用于新能源产品中。

参数	单 位	测试方法
灰色		目视
1~3	mm	ASTM D 374
40±5	Shore C	ASTM D 2240
2.0±0.1	g/cc	ASTM D 792
≥0.1	Мра	ASTM D 412
≥200	%	ASTM D 412
≥1.5	N/mm	ASTM D 624
15.4	Psi	ASTM D 695
27.56	Psi	ASTM D 695
V0		UL-94
-50~180	°C	IEC 60068-2-14
2.0±0.2	W/m•K	ASTM D 5470
≤2.0 (@20Psi/2mm)	°Cin²/W	ASTM D 5470
≥10	KV/mm	ASTM D 149
≥10 <sup>10</sup>	Ω•cm	ASTM D 257
≥2	@1MHz	ASTM D 150
≤0.1	@1MHz	ASTM D 150
	灰色 1~3 40±5 2.0±0.1 ≥0.1 ≥200 ≥1.5 15.4 27.56 V0 -50~180  2.0±0.2 ≤2.0 (@20Psi/2mm) ≥10 ≥10¹0 ≥2	灰色 1~3 mm 40±5 Shore C 2.0±0.1 g/cc ≥0.1 Mpa ≥200 % ≥1.5 N/mm 15.4 Psi 27.56 Psi V050~180 °C 2.0±0.2 W/m•K ≤2.0 °Cin²/W ≥10¹0 Ω•cm ≥2 @1MHz

以上数据由鸿富诚实验室提供,该实验室保留最终解释权

